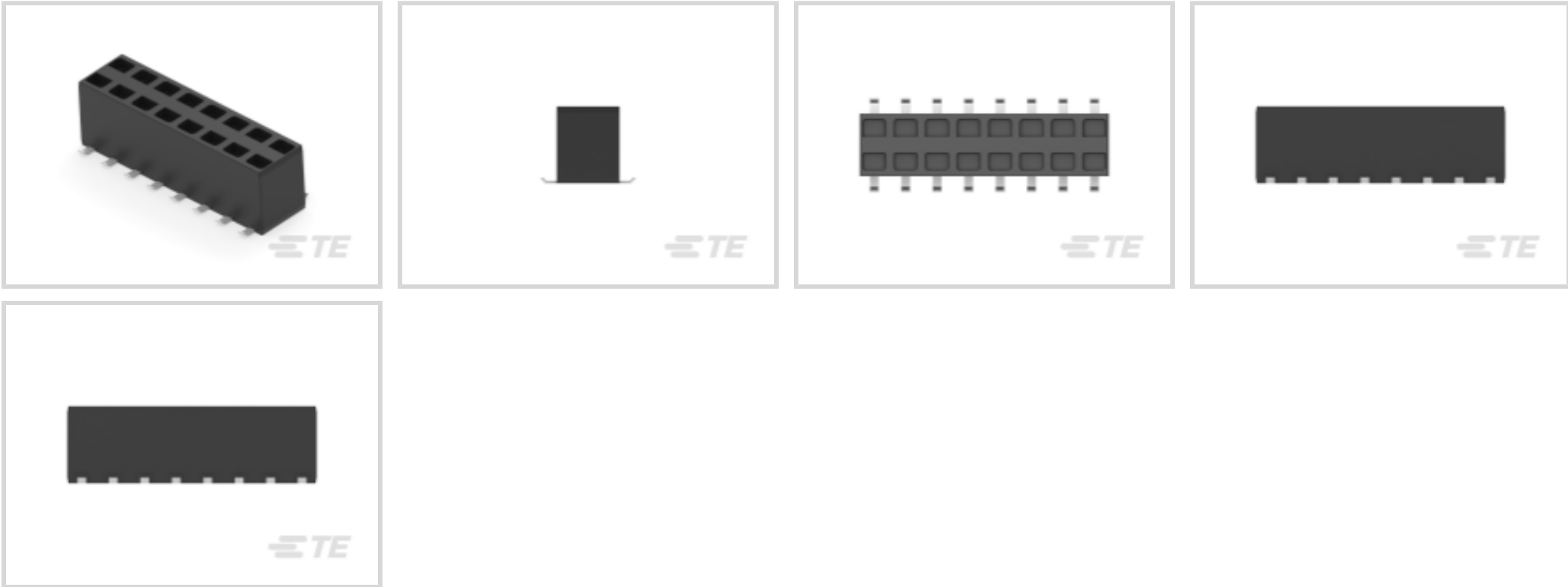




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

连接器系统: 板对板

位数: 16

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
位数	16
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色



接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	.63 mm[.025 in]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.5 μm[98.42 μin]
端子布局	直插式
端子保护类型	闭合入口壳体
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.7 mm[.027 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

接合入口位置	底部和顶部
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	LCP

尺寸

连接器高度	6.2 mm[.244 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]
堆叠高度	9 mm[.354 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]



使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	600
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

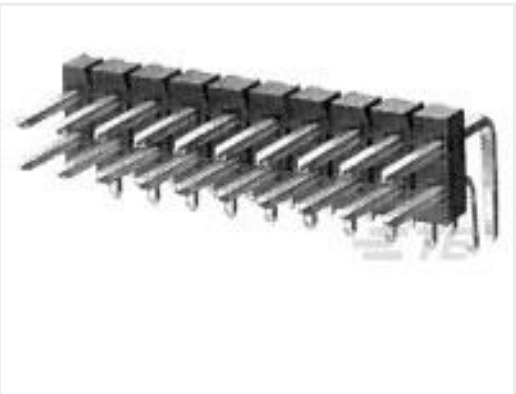
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 826658-8
8P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 826662-8
8P AMPMODU II STIFT LEI



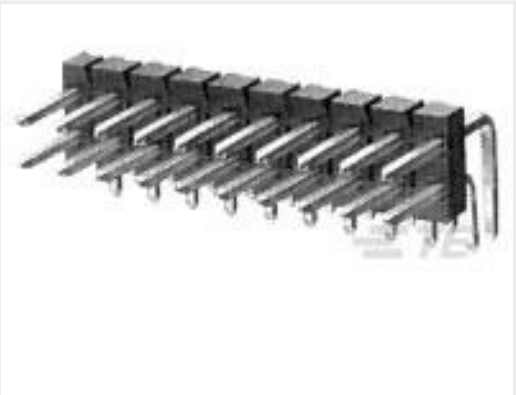
TE 产品编号 966709-8
2X8P MODU II BREAK AWAY HEADER, SMD



TE 产品编号 826632-8
8P AMPMODU II PIN HDR.



TE 产品编号 829394-8
2X8P MOD II UNSHRD HDR, ST, 0.8 AU



TE 产品编号 826634-8
08P MODU 2 PIN HDR



TE 产品编号 966269-8
2x8P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, TUBE PKG



TE 产品编号 1241050-8
2x8P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER

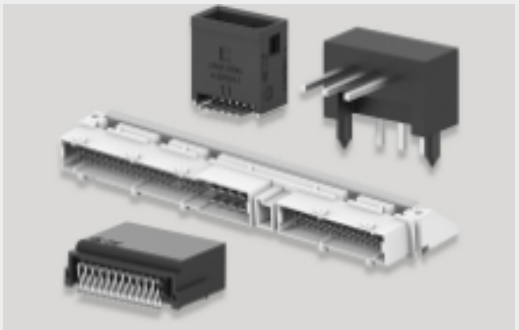


TE 产品编号 826656-8
8P AMPMODU II STIFT LEI

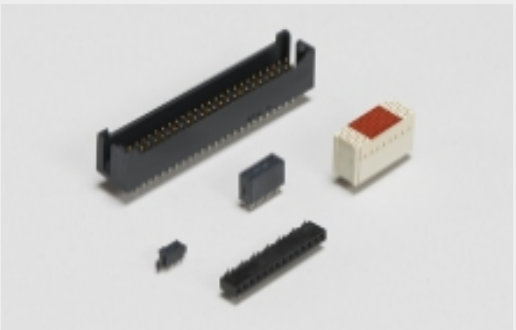


TE 产品编号 826664-8
8P MOD2 STIFT LEI

该系列中的其他产品 | [AMPMODU HV-100/HV-190](#)

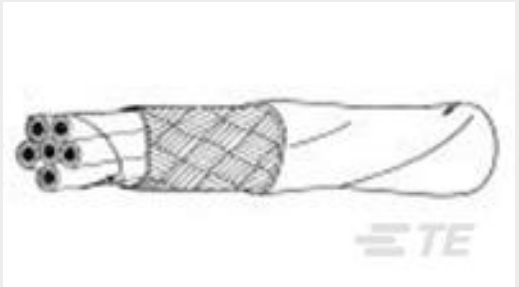


PCB 板端连接器及母端(152)

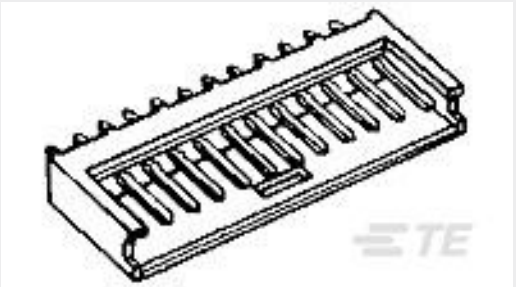


板对板接头和插座(152)

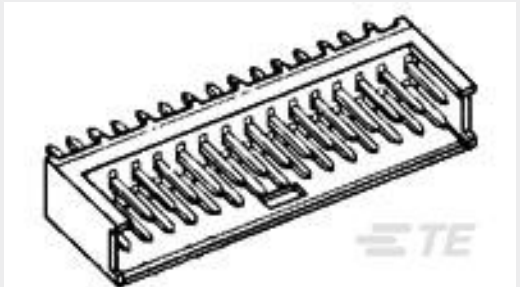
客户还购买了



TE 产品编号6641593001
55A1161-24-0/2/4/5/6/9-9



TE 产品编号280371-1
4P AMPMODU II SHRD HDR, ST, TIN



TE 产品编号280384-2
2X4P AMPMODU II SHRD HDR,ST,0.38 AU



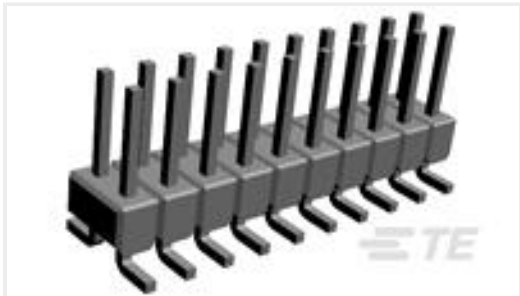
TE 产品编号969973-3
2x3P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER



TE 产品编号969973-6
2x6P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER



TE 产品编号1-969973-2
2x12P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER



TE 产品编号1-1241050-0
2x10P MOD II BREAK AWAY HDR, SMD, BLISTER



TE 产品编号1-1623730-8
BCHE 4 W 470R 5%



TE 产品编号1676413-2
RN 0805 6K04 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1676426-2
RN 0805 750R 0.1% 10PPM 1KRL

文档

2x8P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_969973-8_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_969973-8_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_969973-8_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。